

0,8 mm Stiftleisten

Serie BTE

Technische Daten:

Passend zu:
BSE

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?BTE

Kontakträger:

Liquid Crystal
Polymer



Kontaktmaterial:

Phosphor Bronze

Nennstrom:

2 A bei 80°C
Umgebungstemperatur mit BSE und 5 mm Stapelhöhe

Betriebstemperatur:

-65°C bis +125°C

Nennspannung:

225 VAC mit BSE und 5 mm Stapelhöhe

Oberfläche:

Au über 50µ" (1,27 µm) Ni

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):

230°C/60 Sek.

SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (020-080)
(0,15 mm) .006" max. (100-120)

Empfohlene

Lötspatenstärke:

Bei den meisten Anwendungen müssen (0,05 mm) .002" zu der maximalen SMT-Koplanarität addiert werden.

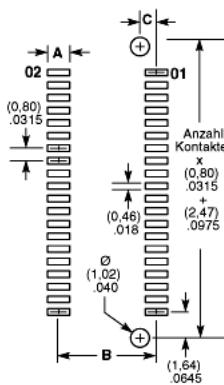
Platinenstapelung:

Maximal zwei Verbinder pro Platinen empfohlen. Wenn Sie für Ihre Anwendungen mehr als zwei Verbinder pro Platinen benötigen, wenden Sie sich bitte an ipg@samtec.com

Empfohlenes

Platinen-Layout:

Gilt nur als Vorschlag. Für weitere Vorschläge zu Platinen-Layouts fragen Sie uns oder besuchen Sie uns unter www.samtec.com?BTE



Leiter-form	A	B	C
-01, -02, -03	(1.45) .057	(6.17) .243	(1.05) .0415
-04, -05	(1.94) .0765	(5.96) .2345	(0.95) .0373

Stapelhöhe

Leiter-form	Höhe im gesteckten Zustand mit BSE
-01	(5,00) .197
-02	(8,00) .315
-03	(11,00) .433
-04	(16,10) .634
-05	(19,10) .752

Stapelhöhen: 14,00 mm, 22,00 mm, 25,00 mm und 30,00 mm. Fragen Sie uns.

Anwendungsspezifische Optionen

30µ" (0,76 µm)
Gold und Reibungsverschluss lieferbar.
Fragen Sie uns.



BTE

Anzahl Kontakte pro Reihe

- 020, - 040, - 060,
- 080, - 100, - 120

Leiter-form

Auswahl der Leiter-form nach der Tabelle

Kontaktmaterial

- F
= hauchvergoldet

- L
= 10µ" (0,25 µm) Gold

Optionen

- K
= Ø (7,00 mm)
.275"
Polyimid
Film Pick & Place Pad

- TR
= Tape & Reel
(Max. 60
Kont./Reihe.
Nicht mit -05)

Leiter-form	A
- 01	(4,27) .168
- 02	(7,21) .284
- 03	(10,26) .404
- 04	(15,24) .600
- 05	(18,24) .718

